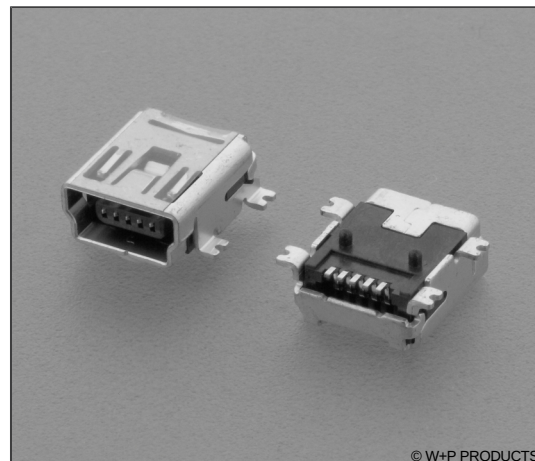


SMT-Mini-USB Steckverbinder, Type B, Buchse liegend

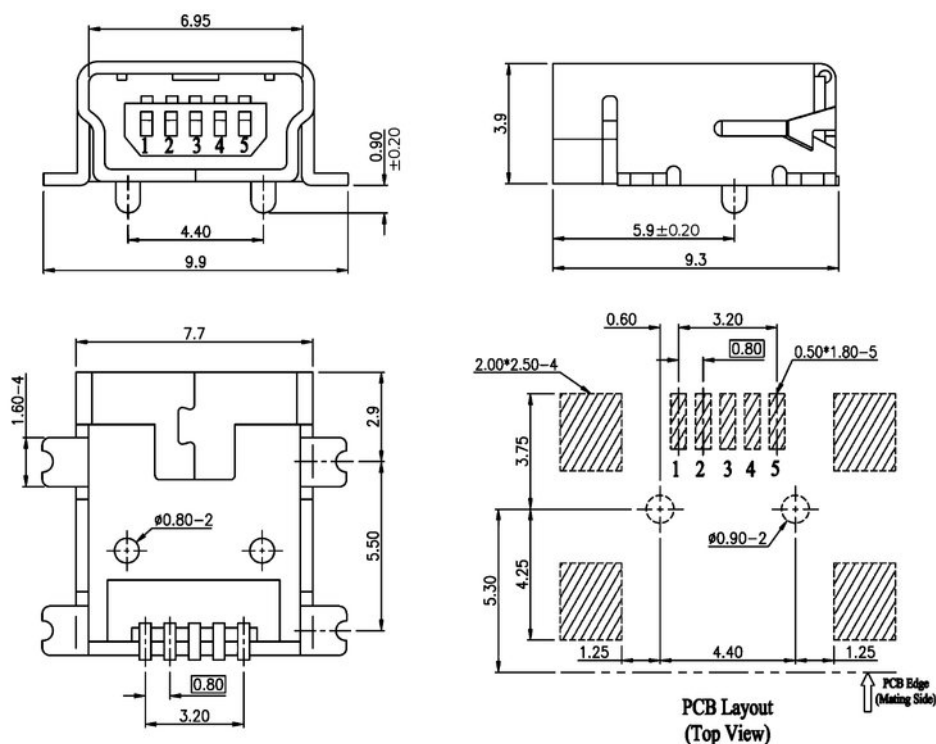
SMT Mini-USB Connectors, Type B, Jacks, Horizontal

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing, verzinkt
Shell	Tin plated brass
Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	Gold over nickel (see options below)
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	Tin plated over nickel
Durchgangswiderstand	< 50mΩ
Contact Resistance	< 50mΩ
Isolationswiderstand	> 100MΩ
Insulation Resistance	> 100MΩ
Spannungsfestigkeit	100V _{AC}
Test Voltage	100V _{AC}
Nennspannung	30V _{RMS}
Voltage Rating	30V _{RMS}
Nennstrom	1,5A bei 25°C
Current Rating	1,5A at 25°C
Temperaturbereich	-20°C ... +70°C
Temperature Range	-25°C ... +70°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS



Series	Type	Contacts	Plating*	Packing*
8233	2	05	60	FTR
	2 Type B (female)		60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)	FTR (Option) Tape & Reel Verpackung, Folien-Pads Tape & Reel Packing, film tape

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

